

ハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム、新仕様をリリース
－ HMC の性能向上と業界レベルでの採用を推進 －

米カリフォルニア州サンノゼ、米アイダホ州ボイシー、2014 年 11 月 20 日
(GLOBE NEWSWIRE) -- ハイブリッドメモリキューブ (HMC) 用インタフェースの業界仕様の開発に尽力しているハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム (HMCC) は本日、HMCC 2.0 仕様が完成し、公開したと発表しました。

新しい HMCC 2.0 仕様ではデータ転送速度が 15Gb/s から 30Gb/s に向上しており、メモリ性能の新しい閾 (しきい) 値を確立するものです。また既存の産業分類との整合性を図るために、関連チャネルモデルが短距離 (SR) から超短距離 (VSR) に移行しています。

半導体関連の調査機関である Objective Analysis の取締役である Jim Handy 氏は次のように述べています。「メンバー数 150 を擁するハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアムは、その設立以来大きなモメンタムを得ており、その結果、インタフェースを今後のアプリケーションに最適にマッチさせる上で、ますます良好なインプットを得るようになっていきます。HMCC 2.0 仕様のリリースは、あらゆる高性能コンピューティングアプリケーション向けの仕様を発展させていくことへの HMCC の注力を示すものです」

HMCC は共同開発企業である Altera、マイクロンテクノロジー、Open-Silicon、サムスン電子、Xilinx によって 2011 年 10 月に設立されました。HMCC は 2013 年 5 月に最初の仕様の完成し、リリースしました。それは主要な半導体開発企業の間で HMC を次世代システムに採用するためのコンセンサスが得られたことを示すものでした。HMCC は設立以降、150 を超える OEM、イネーブラ、インテグレータを含む規模に成長しており、メンバーは定期的に HMC 規格の開発と議論に参加しています。HMCC 仕様の第 2 世代の完成は、この革新的なメモリ技術の開発における重要な節目であり、今後も HMC が採用されることを示すものです。

Open-Silicon の IP およびエンジニアリング・オペレーション担当副社長である Hans Boumeester 氏は次のように述べています。「HMCC 2.0 により、設計者はメモリのボトルネックを突破し、未曾有のメモリ性能を有する新世代のシステムを提供する完成度の高いソリューションを手に入れます。新しい規格の承認は、こうした設計者が規格に準拠した IP にアクセスし、次世代データセンタや高性能コンピューティングアプリケーションに関する帯域幅の需要増を満たすチップやシステムに直接集積できるようになることを意味しています」

HMC について

HMC は従来のメモリテクノロジーによる制約を打破する待望の解決策であると認識されており、ビットあたり消費電力を大幅に削減した超高性能システムを提供するものです。現在の HMC の帯域幅は DDR3 モジュールの 15 倍、消費電力は 70%削減、さらに占有面積は従来のテクノロジーと比べて 90%縮小されています。HMC のアブストラクテッドメモリ（抽象化メモリ）により、設計者は HMC の画期的な特長と性能の活用により時間をかけられると同時に、基本的な機能を実行するために必要なさまざまなメモリパラメータの操作時間を削減できます。また、エラー修正、障害からの回復、リフレッシュ、およびメモリのプロセス変動により悪影響を受けるその他のパラメータを管理することができます。

HMCC について

世界的な半導体コミュニティのトップメンバーにより設立されたハイブリッドメモリキューブ・コンソーシアム（HMCC）は、ハイブリッドメモリキューブ用インタフェースの業界仕様の開発に尽力しています。コンソーシアムの現在のメンバーは、Altera Corporation、ARM、IBM、マイクロンテクノロジー、Open-Silicon, Inc.、サムスン電子、SK hynix Inc.、Xilinx, Inc. 等です。HMCC の詳細については www.hybridmemorycube.org をご覧ください。

お問い合わせ先： Karl Stetson
Zeno Group for Micron
Karl.stetson@zenogroup.com
206-297-5943